

芯联集成电路制造股份有限公司

关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和 2026 年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2026 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，同时对减值影响因素确认消失的资产，在原已计提的减值损失金额内进行转回/转销。现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

公司本次计提信用减值损失 1,220.89 万元，转回信用减值损失 0 万元；计提资产减值损失 49,814.77 万元，转销资产减值损失 42,305.98 万元。计提及转回/转销各项资产减值准备合计将减少公司 2026 年半年度利润总额 8,729.68 万元。具体情况如下所示：

单位：万元

序号	项目	计提金额	本期减少金额		备注
			转回	转销	
1	信用减值损失	1,220.89	0	0	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
2	资产减值损失	49,814.77	0	42,305.98	存货跌价损失
合计		51,035.66	0	42,305.98	/

二、2026 年半年度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、预付款项进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2026 年半年度计提信用减值损失金额 1,220.89 万元，转回信用减值损失 0 万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。2026 年半年度计提存货跌价损失金额 49,814.77 万元。同时，由于报告期内部分前期已计提减值的产品以前计提减值的影响因素已经消失或实现对外出售，2026 年半年度在原已计提的存货跌价准备金额内，转销 42,305.98 万元。本报告期计提及转销存货跌价损失将影响公司 2026 年半年度利润总额 7,508.79 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提及转回/转销各项资产减值准备将减少公司 2026 年半年度利润总额 8,729.68 万元。公司本次计提、转回/转销资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司实际情况。相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止 2026 年 6 月 30 日的财务状况和 2026 年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日